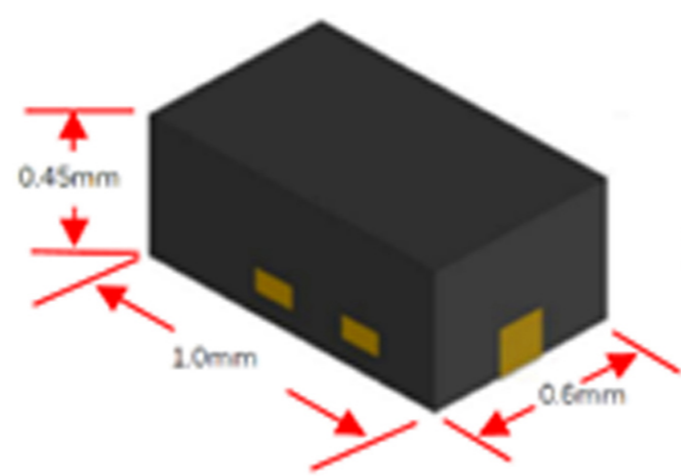
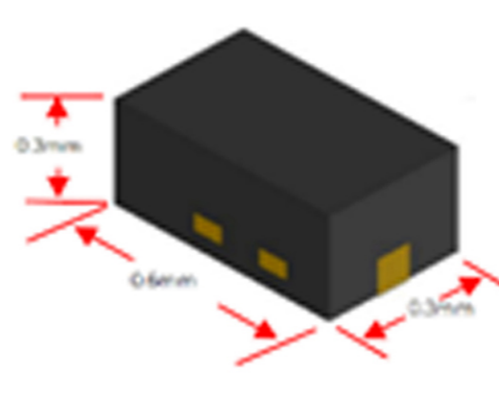


应用于面板端口的ESD产品

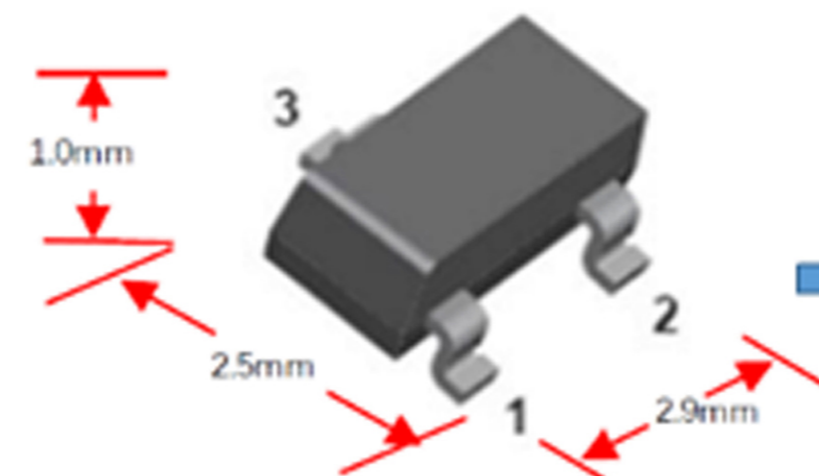
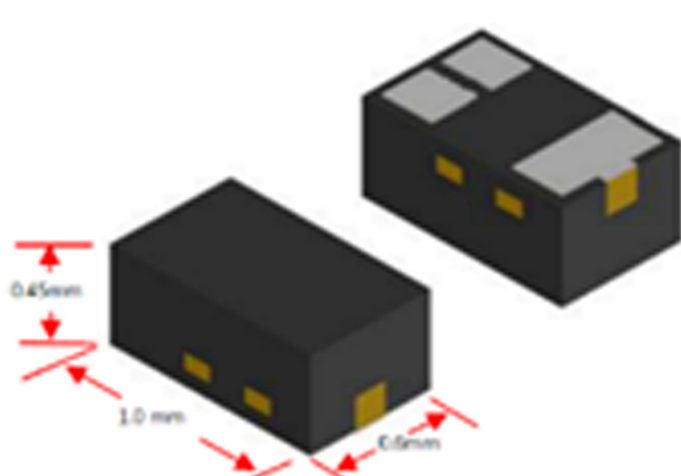
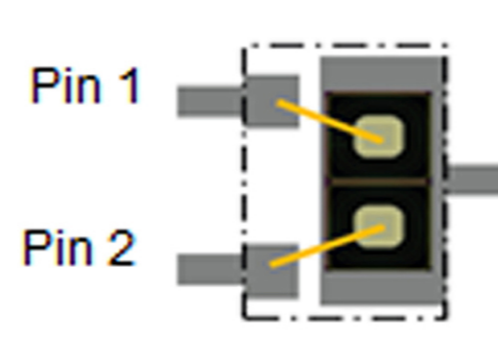
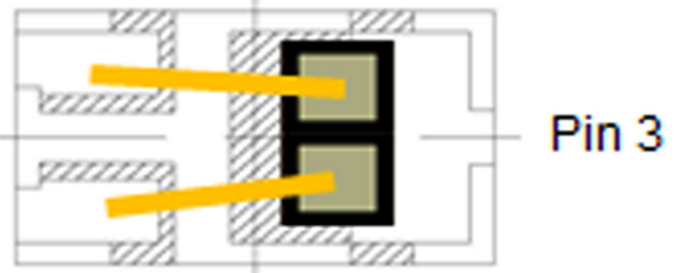
随着电子产品的升级，产品趋势为小型化，轻薄化，从而要求电子器件产品在保留大封装性能的前提下，实现封装集成小型化，我们针对这样的产品发展趋势，设计出DFN0603封装替代DFN1006封装，DFN1006-3L封装替代SOT-23封装的产品，节约客户电路板空间，可广泛应用于手机、PC主板的显示、音频、Type-C, NFC等接口的ESD防护。

产品特点

1. 小封装大功率：使用DFN0603封装，可以达到DFN1006封装产品IPP参数性能，体积缩小80%。

	DFN1006-2L	DFN0603-2L
外观		
长	1	0.6
宽	0.6	0.3
高	0.45	0.3
优势	占用空间缩小 80%	

2. DFN1006-3L双路，可以替代SOT-23封装或者2只DFN1006-2L封装产品。替代SOT-23时，空间缩小90%

	SOT-23	DFN1006-3L
外观		
内部结构		
长	2.9	1
宽	2.5	0.6
高	1	0.45
优势	占用空间缩小 90%	

3. 高可靠性性能。

4. 采用环保物料，符合RoHS标准；

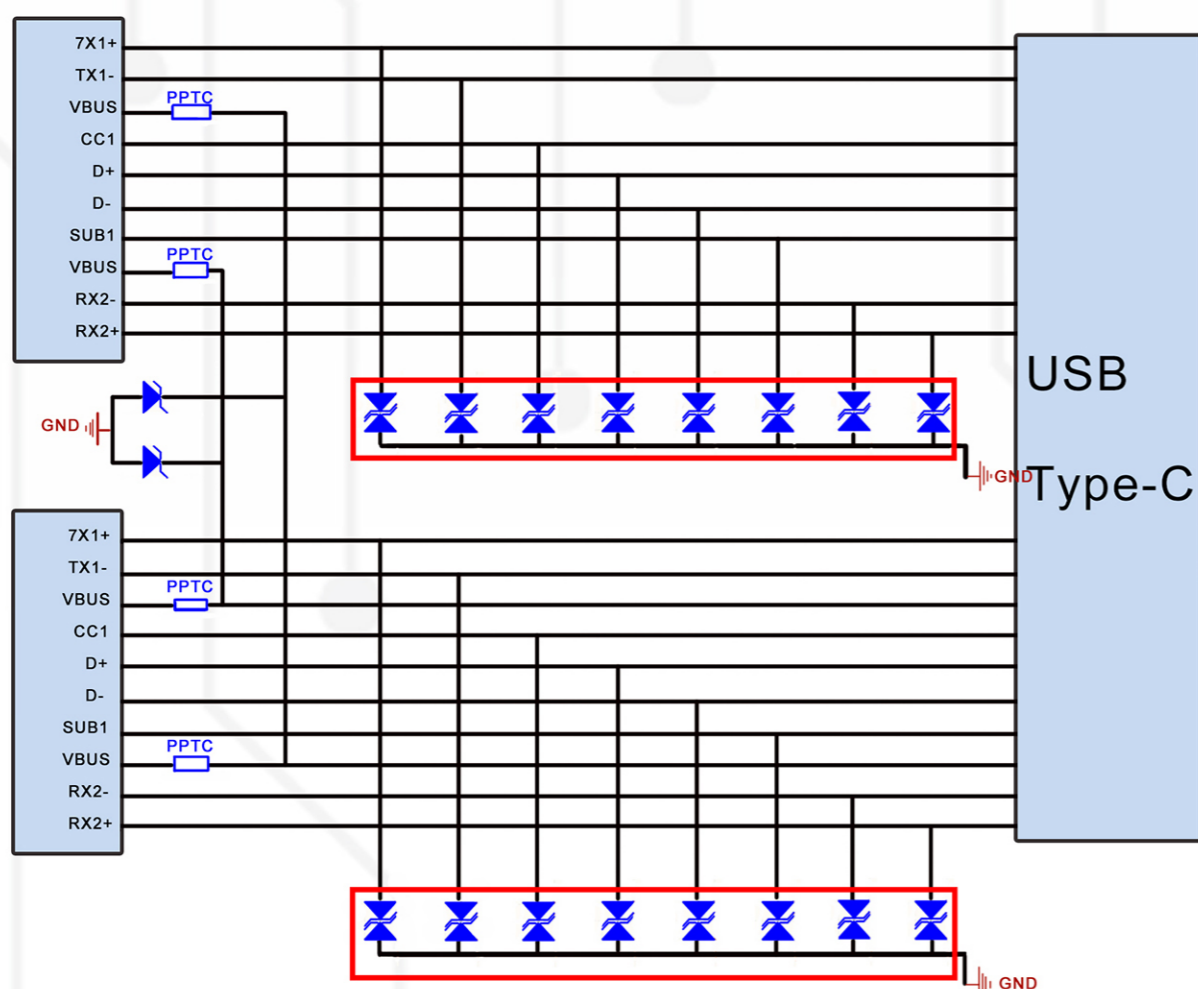
产品系列

P/N	VRWM(V)	IPP MAX(A) @8/20μs	VC(V) @IPP MAX	Cj(pF) Typ	Package
ESD2V1LZA	2.1	22	6.6	65	DFN0603-2L
ESD3V6LZBA	3.6	20	7.5	36	DFN0603-2L
ESD5V0LZA	5	18	11	49	DFN0603-2L
ESD7V9LZA	7.9	15	13	40	DFN0603-2L
ESD12VLZA	12	8	20	35	DFN0603-2L
VESDSL3V3LZBA	3.3	5	7	0.5	DFN0603-2L
VESDULC5V0LZB	5	4	11	0.5	DFN0603-2L
VESD3V3LZB	3.3	9	10	13	DFN0603-2L
VESD5V0LZB	5	8	12	15	DFN0603-2L
ESDSL5V0LT	5	3.5	12	0.4	DFN1006-3L
ESD5V0LTB	5	8	10	10	DFN1006-3L

应用电路

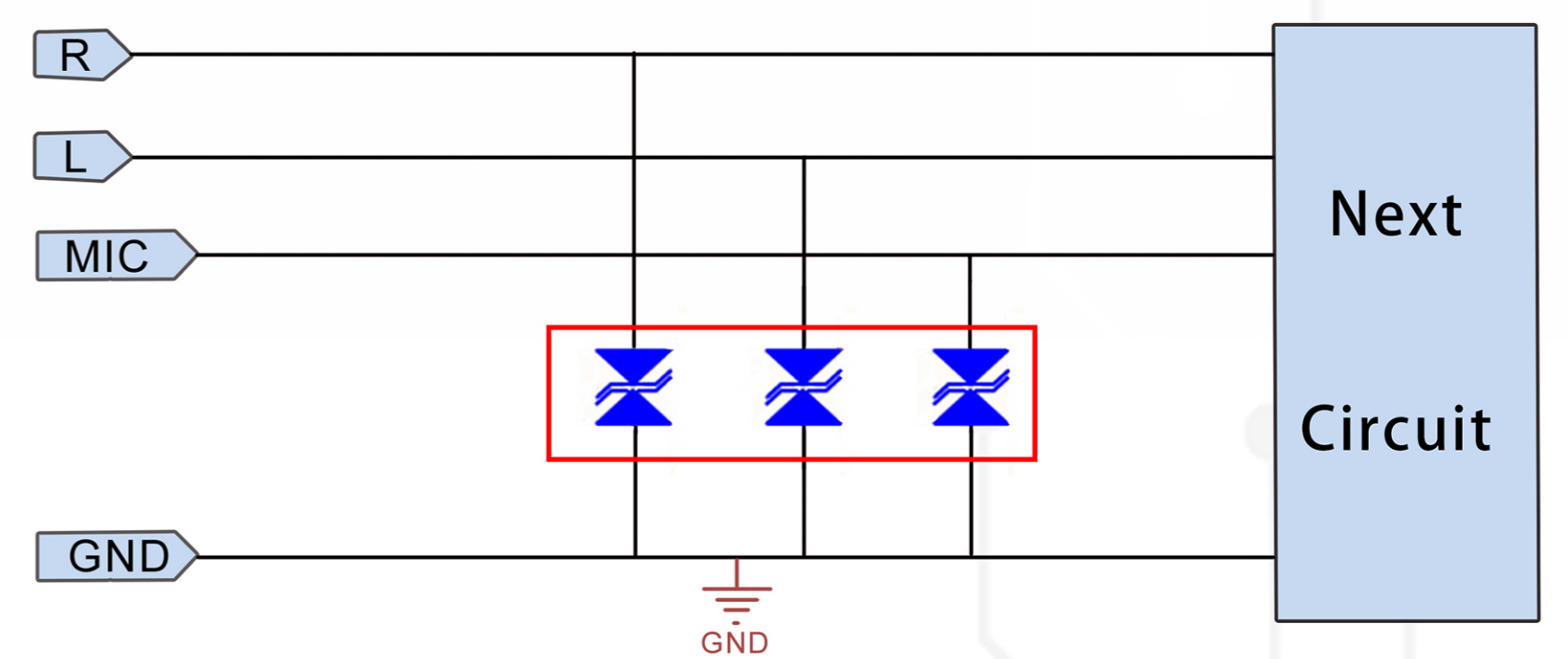
(1)、Type-C

VESDSL5V0LBS/VESDULC5V0LZB



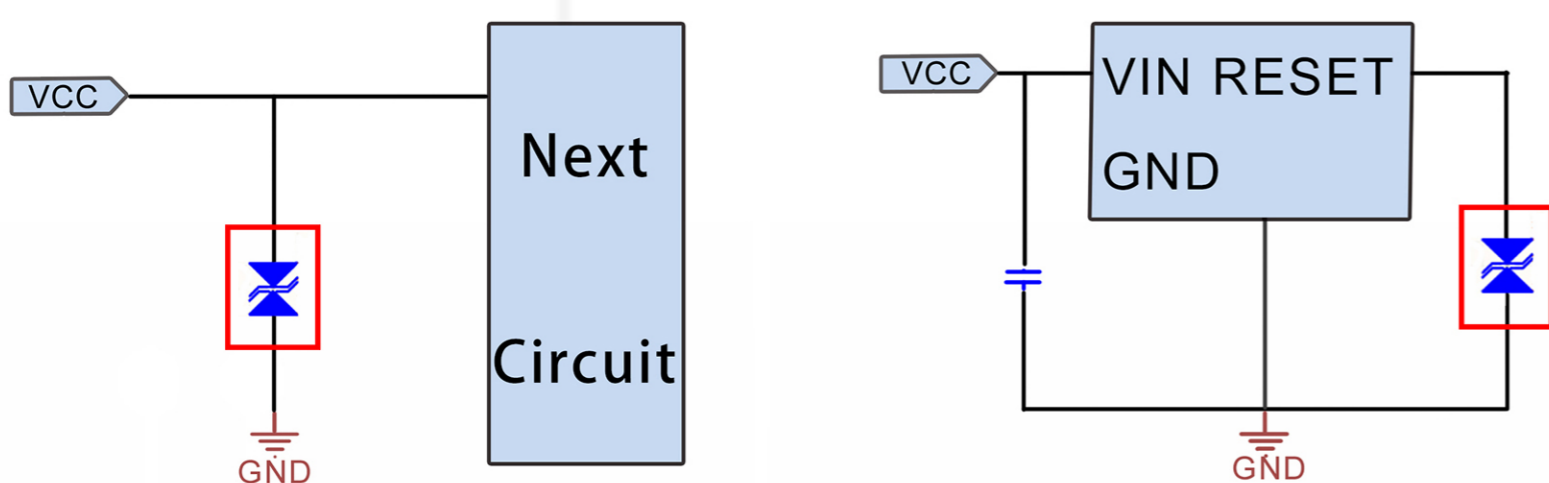
(2)、音频

VESD5V0LBA



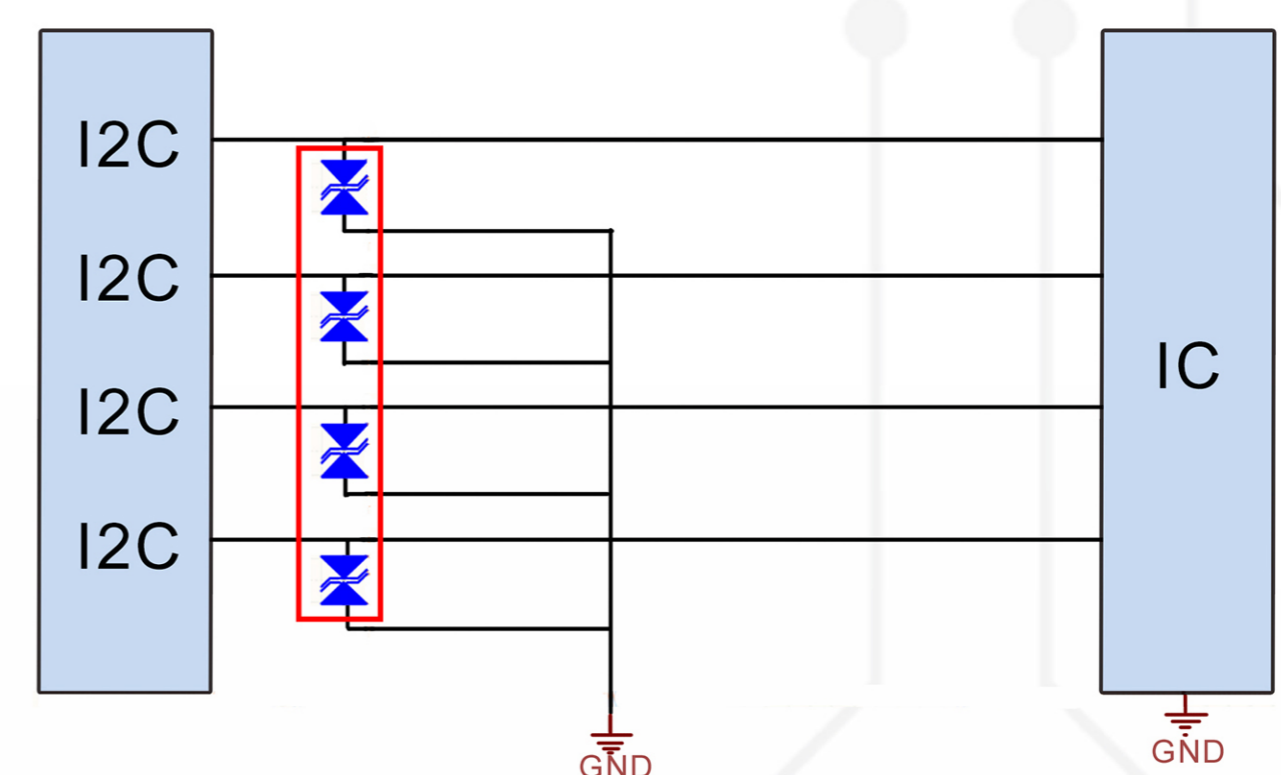
(3)、话筒

VESD5V0LBA



(4)、触摸屏

VESDSL5V0LBS/VESDULC5V0LZB



应用领域

手机、电脑及周边智能穿戴

